

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成22年11月18日(2010.11.18)

【公開番号】特開2010-45393(P2010-45393A)

【公開日】平成22年2月25日(2010.2.25)

【年通号数】公開・登録公報2010-008

【出願番号】特願2009-260283(P2009-260283)

【国際特許分類】

H 01 L 25/00 (2006.01)

H 01 L 23/12 (2006.01)

H 05 K 3/46 (2006.01)

【F I】

H 01 L 25/00 B

H 01 L 23/12 B

H 05 K 3/46 Q

【手続補正書】

【提出日】平成22年10月4日(2010.10.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と、

前記基板上に設けられ、巻線を内蔵する第1の樹脂層と、

前記第1の樹脂層上に設けられ、ICを内蔵する第2の樹脂層と、
を備え、

前記基板は、前記基板表面から前記第1の樹脂層中に突出し、セラミックスからなる第1の突起を有し、

前記第1の樹脂層中において、前記巻線は、前記第1の突起の周囲を周回するように配置され、

前記第2の樹脂層中において、前記ICは、前記第1の突起と重なるように配置されており、

前記巻線の端部は、前記第2の樹脂層中に設けられたビアを介して、前記第2の樹脂層における前記第1の樹脂層とは反対側の表面に電気的に引き出された配線が直接接続されている、電子部品モジュール。

【請求項2】

前記ICは、前記ICの前記基板表面への投影面が、前記第1の突起の前記基板表面による断面領域をはみ出して配置されている、請求項1に記載の電子部品モジュール。

【請求項3】

前記基板は、前記基板表面から前記第1の樹脂層中に突出し、前記第1の突起の周囲を周回する前記巻線の周囲に配置され、セラミックスからなる第2の突起をさらに備え、

前記第2の樹脂層中において、前記ICは、前記第1の突起と、前記第2の突起と、をまたがって配置されている、請求項1又は2に記載の電子部品モジュール。